doi: 10.11933/j.issn.1007-9289.20190510003

# 镍钴合金在低共熔溶剂中的共沉积行为

李文若1,郝建军1,牟世辉2

(1. 沈阳理工大学环境与化学工程学院, 沈阳 110159; 2. 沈阳理工大学 材料科学与工程学院, 沈阳 110159)

**摘 要:**在低共熔型离子液体氯化胆碱-乙二醇(ChCl-EG)体系下对镍钴(Ni-Co)合金共沉积行为进行研究。采用循 环伏安法(CV)、计时电流法(CA)研究 Ni-Co合金在 ChCl-EG 中的电化学行为,通过傅里叶红外光谱(FT-IR)对 ChCl-EG 及添加不同金属盐的体系进行红外吸收分析,使用扫描电子显微镜(SEM/EDS)分析 Ni-Co合金微观形貌及元素组 成,结合 X 射线衍射仪(XRD)对 Ni-Co合金进行物相分析。结果表明:ChCl-EG 体系是以胆碱结构和氢键结构形式存 在;70℃下,ChCl-EG 体系中 Ni-Co合金的还原电位范围为 -0.6~-1.13 V,而 Ni-Co合金形核过程遵循三维成核生长规 律;在恒电位下制备得到的 Ni-Co合金微观形貌为均匀致密的球形晶粒,且通过控制电位可以得到不同 Co含量的 Ni-Co 合金镀层。

关键词:离子液体;镍钴合金;循环伏安法;电结晶机理 中图分类号:TQ153.19 文献标志码:A 文章编号:1007-9289(2020)02-0057-08

#### **Co-deposition Behavior of Ni-Co Alloy in Deep Eutectic Solvent**

LI Wenruo<sup>1</sup>, HAO Jianjun<sup>1</sup>, MU Shihui<sup>2</sup>

(1. School of Environmental and Chemical Engineering, Shengyang Ligong University, Shengyang 110159, China; 2. School of Materials Science and Engineering, Shengyang Ligong University, Shengyang 110159, China)

**Abstract**: The co-deposition behavior of nickel-cobalt (Ni-Co) alloy was studied in deep eutectic solvent of the choline chloride-ethylene glycol (ChCl-EG) system. Cyclic voltammetry (CV) and chronoamperometry (CA) were measured to study the electrochemical behavior of Ni-Co alloy in ChCl-EG. The infrared absorption of ChCl-EG and ChCl-EG containing different metal salts were analyzed by fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). The microstructure and elemental composition of Ni-Co alloy were characterized by scanning electron microscopy (SEM/EDS) and the crystalline phases of Ni-Co alloy was detected by X-ray diffractometry (XRD). Results show that the ChCl-EG system has two structures of choline structure and hydrogen bond structure. At 70°C, the reduction potential of Ni-Co alloy in ChCl-EG system is  $-1.13 \text{ V} \sim -0.6 \text{ V}$ . The nucleation process of Ni-Co alloy is a three-dimensional nucleation and growth. The grains of the Ni-Co alloy prepared by electro deposition at a constant potential is uniform and spherical. Moreover, the Ni-Co alloy with different Co contents can be obtained by controlling the potential.

Keywords: ionic liquid; Ni-Co alloy; cyclic voltammetry; electrocrystallization mechanism

# 0 引 言

近年来,由于离子液体具有较宽的电化学窗口,优良的导电性,高的热稳定性,几乎无蒸汽出现,无有毒气体排放等特点,在有机合成、多孔材

料制备、CO<sub>2</sub>吸附以及金属还原等方面受到关注<sup>[1-3]</sup>。特别是在金属还原方面,克服了常规电 镀存在的问题,目前主要研究重点为稀有金属及 其合金的制备以及金属离子的电化学行为研究 等,如 Legeai 等<sup>[4]</sup>研究 1-辛基-1-甲基吡咯烷酮双

收稿日期: 2019-05-10; 修回日期: 2020-02-10

通信作者:郝建军(1970—),男(汉),副教授,博士;研究方向:表面处理及功能材料; E-mail: hjj68881@163.com

LI W R, HAO J J, MU S H. Co-deposition behavior of Ni-Co alloy in deep eutectic solvent [J]. China Surface Engineering, 2020, 33(2): 57-64.

引用格式:李文若,郝建军,牟世辉. 镍钴合金在低共熔溶剂中的共沉积行为[J]. 中国表面工程, 2020, 33(2): 57-64.

(三氟甲基磺酰基) 酰亚胺离子液体在敞开体系 下电沉积制备镧;Li 等<sup>[5]</sup>在氯化胆碱-尿素体系 中对 Co<sup>2+</sup>的电化学行为进行研究;谭勇等<sup>[6]</sup>在氯 化胆碱-乙二醇体系中对 Ni<sup>2+</sup>的电化学行为进行 研究;Yang 等<sup>[7]</sup>在 1-丁基 3-甲基咪唑四氟硼酸 盐离子液体中电沉积制备得到铜锂(Cu-Li)合 金;Wang 等<sup>[8]</sup>在氯化胆碱-尿素体系中制备镍铜 (Ni-Cu)合金等等。

Ni-Co 合金具有良好的磁性能、储氢性、耐磨 性和化学稳定性等优点<sup>[9]</sup>,在储氢合金电极,合 金装饰镀层,磁性材料等<sup>[10-11]</sup>许多领域内得到广 泛应用。工业生产中常采用电沉积法制备 Ni-Co 合金,但是电沉积制备 Ni-Co 合金过程中析氢严 重,经常导致镀层发生氢脆,且电解液后期处理 容易造成二次污染,如何解决上述问题一直是研 究重点。近几年于离子液体中制备 Ni-Co 合金的 研究逐渐被报道,如 You 等<sup>[12]</sup>在氯化胆碱体系 中通过调整电解液主盐含量制备得到3种不同 组份的 Ni-Co 合金,经讨论证明 Ni-Co 合金在低 共熔溶剂中的共沉积行为为非异常共沉积;Srivastava 等<sup>[13]</sup>在同体系下对不同 Co 含量的 Ni-Co 合金进行晶型以及腐蚀性能研究发现,随 Co 含 量升高合金晶型从面心立方向体心立方转变,但 是无论含量如何变化纯 Ni 镀层的腐蚀性能都要 优于 Ni-Co 合金。目前针对离子液体中制备 Ni-Co合金的研究多在组分含量方向,而对于 Ni-Co 合金在离子液体中的电结晶机理研究较少。

在低共熔型离子液体氯化胆碱-乙二醇 (ChCl-EG)体系下,研究了 Ni-Co 合金在 ChCl-EG 体系中的电化学行为,探讨了低共熔型离子 液体中 Ni-Co 合金的共沉积机理。

## 1 试验准备

#### 1.1 电解液制备

氯化胆碱纯度 99%,购于国药集团化学试剂 有限公司;乙二醇纯度 98%,购于长春市化学试 剂有限公司;无水乙醇(分析纯)和氯化钴(分析 纯)、氯化镍(分析纯)购于天津市富宇精细化工 有限公司;试验用水为去离子水。

将氯化胆碱与乙二醇按照摩尔比 1:2,在 70℃下混合恒温搅拌 2 h,形成无色透明状离子 液体。取制备好的离子液体 50 mL,分别向其加 入 1. 19 g NiCl<sub>2</sub> • 6H<sub>2</sub>O 及 0. 24 g CoCl<sub>2</sub> • 6H<sub>2</sub>O, 于 70 ℃下恒温搅拌 2 h 至完全溶解, 制备得到深绿 色电解液, 制备条件为敞开体系。

## 1.2 分析与测试

使用 Bruker Vertex70V Spectrometer 傅里叶 红外光谱(FT-IR)对 ChCl-EG 及添加不同金属盐 体系进行结构分析,溴化钾压片,液膜法测量:采 用 CHI660E 电化学工作站, 通过循环伏安法 (CV)与计时电流法(CA)研究在氯化胆碱-乙二 醇体系下 Ni-Co 合金共沉积行为,使用三电极体 系,辅助电极为213型铂电极,216型银电极做参 比电极,工作电极使用直径 3 mm 的玻碳电极 (CV、CA)和1 cm×2 cm 纯铜片(恒电位沉积), 电极均位于溶液下1 cm 处。循环伏安测试条 件:温度 70 ℃,电位区间-1.4~1.5 V,扫描速率 为 50 mV/s, 计时电流测试条件: 温度 70 ℃, 时间 30 s, 电位-0.8~-1.1 V, 阶跃次数一次, 扫描速 率为 50 mV/s。使用 VEGA3 XMV 型扫描电子显 微镜 SEM(EDS) 观察镍钴合金微观形貌以及元 素组成:通过 6100 型 X 射线衍射仪进行晶型分 析,测试条件为,Cu 靶 Kα 射线,电压 40 kV,电流 30 mA.2θ 扫描范围为 40°~80°。

## 2 结果与讨论

#### 2.1 ChCl-EG 的红外吸收光谱分析

图 1 为 ChCl-EG 体系及 ChCl-EG 体系添加 NiCl,、CoCl, 和 NiCl,+CoCl, 的红外吸收光谱。

图 1 中可见在 3500~3000 cm<sup>-1</sup> 处存在较宽的 吸收峰,是氯化胆碱与乙二醇混融后形成的一系



图 1 ChCl-EG 体系及 ChCl-EG 体系中添加 NiCl<sub>2</sub>、CoCl<sub>2</sub> 和 NiCl<sub>2</sub>+CoCl<sub>2</sub> 的红外吸收光谱

Fig. 1 Infrared absorption spectra of ChCl-EG system and ChCl-EG system with NiCl<sub>2</sub>,  $CoCl_2$  and  $NiCl_2+CoCl_2$ 

列分子间氢键(包括 C-H、N-H、O-H 键等)的特征峰,为低共熔型离子液体的主要键能,1049 cm<sup>-1</sup>与 1095 cm<sup>-1</sup>为 C-O 的拉伸振动,954 cm<sup>-1</sup>为 CCO 的不对称拉伸振动,603 cm<sup>-1</sup>与 511 cm<sup>-1</sup>为 C-H 的变形振动,说明存在游离的胆碱结构。随着金属盐的加入,混合体系与纯 ChCl-EG 体系相比红外吸收峰位置几乎不变,说明金属盐的引入没有破坏低共熔型离子液体 ChCl-EG 原有的有机结构。

## 2.2 Ni-Co 合金在 ChCl-EG 体系中的电化学行为

图 2 是 ChCl-EG 体系及 ChCl-EG 体系中添 加 NiCl<sub>2</sub>、CoCl<sub>2</sub> 和 NiCl<sub>2</sub>+CoCl<sub>2</sub> 的循环伏安曲线, 其中 a 曲线为纯 ChCl-EG 体系下的循环伏安曲 线,可以看出,当电位低于-1.2 V 时,由于氯化 胆碱或溶剂中残留的水发生的还原反应,导致电 流下降,并且电极表面出现气泡。当电位大于 1.0 V 时,电流出现明显上升,是由于体系中氯化 胆碱分解生成的 CI<sup>-</sup>发生氧化反应引起的<sup>[14]</sup>。 由此可知 ChCl-EG 体系的稳定电化学窗口为 -1.2~1.0 V,因此试验选定循环伏安曲线测试 范围-1.2~1.0 V。



图 2 ChCl-EG 体系及 ChCl-EG 体系中添加 NiCl<sub>2</sub>、CoCl<sub>2</sub> 和 NiCl<sub>2</sub>+CoCl<sub>2</sub> 的循环伏安曲线

Fig. 2  $\,$  CV of ChCl-EG system and ChCl-EG system with NiCl\_2, CoCl\_2 and NiCl\_2+CoCl\_2

图 2 中曲线 b, c, d 分别是在 ChCl-EG 体系 中加入 1 mol/L NiCl<sub>2</sub>、0.2 mol/L CoCl<sub>2</sub>、1 mol/L NiCl<sub>2</sub>+0.2 mol/L CoCl<sub>2</sub> 的循环伏安曲线。从还原 过程来看, b 曲线在-0.7~0.95 V 与-0.95~ -1.1 V 出现两个还原峰 B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>,为分析还原峰产 生的原因,在-0.95 V 进行回扫(图 3)发现,回扫 过程中出现了"电流滞环"现象,证明电结晶依然 存在<sup>[15]</sup>,说明 Ni<sup>2+</sup>的还原存在成核过电位,B<sub>1</sub> 与 B, 峰都是 Ni<sup>2+</sup>的还原过程。



图 3 ChCl-EG+NiCl<sub>2</sub> 体系于-0.75 V 回扫的循环伏安图 Fig. 3 CV of potential sweepback at -0.75 V in ChCl-EG+NiCl<sub>2</sub>

为了进一步研究两个还原峰的出现原因,以 两个相同的铜片做工作电极,在 ChCl-EG+NiCl, 体系中分别于-0.75 V和-1.1 V处进行恒电位 还原 30 min。得到的镀层的 SEM/EDS 见图 4,可 以明显看到两种镀层均为金属镍镀层,区别在于 -0.75 V下还原得到的镍镀层微观形貌平整致 密,而在-1.1 V下还原得到的镍镀层微观形貌 为针状结构。根据以上研究推断两个还原峰的 出现原因,是由于在离子液体中还原出了不同结 构的金属镍所导致<sup>[16]</sup>。

c曲线在-0.75~-1.1 V出现 Co的还原峰。 d曲线在-0.6~-1.06 V与-1.06~-1.13 V出现 两个还原峰 D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>,为了研究 Ni-Co 合金的共沉 积行为,在-1.1 V 位置进行回扫(图 5)发现,回 扫过程中同样出现"电流滞环"现象,说明 Ni-Co 合金的还原过程存在成核过电位,D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>都是电 结晶过程,其中 D,为 Ni<sup>2+</sup>还原增强的富镍合金 峰,此现象多在共沉积合金中出现<sup>[17]</sup>。b曲线中 Ni-Co 合金的还原峰 D<sub>1</sub> 在-0.5~-1.06 V 之间, 且还原峰最大值位于纯 Ni 与纯 Co 还原峰最大 值之间,说明在 ChCl-EG 体系中 Ni-Co 合金共沉 积时, Co<sup>2+</sup>的还原电位正移, Ni<sup>2+</sup>的还原电位负 移,这是由于 Ni<sup>2+</sup>与 Co<sup>2+</sup>之间存在相互作用, Ni<sup>2+</sup> 的存在会促进 Co<sup>2+</sup>的还原,使得 Co<sup>2+</sup>的还原峰正 移,同时,由于电极表面自由电子转移与 Co<sup>2+</sup>在 电极表面的还原,产生阴极极化作用,从而导致 Ni<sup>2+</sup>的还原电位负移,Ni-Co合金在ChCl-EG中的 共沉积方式为非异常共沉积[12-13]。







图 5 ChCl-EG+NiCl<sub>2</sub>+CoCl<sub>2</sub>体系于-1.1 V 回扫的循环 伏安图

Fig. 5 CV of potential sweepback at -1.1 V in ChCl-EG+  $\mathrm{NiCl}_2\mathrm{+CoCl}_2$ 

从氧化过程来看,图 2 中曲线 b 在-0.25~ 0.5 V 内出现氧化峰 B<sub>3</sub>(峰电位为 0.183 V),是 Ni 的溶解过程;曲线 c 在-0.5~0.2 V 区域出现 氧化峰  $C_2$ (峰电位为 0.13 V),是 Co 的溶解过 程;曲线 d 在  $-0.2 \sim 0.5$  V 内出现氧化峰  $D_3$ (峰 电位为 0.394 V),是 Ni-Co 合金的溶解过程,图 中氧化电位最负的为  $D_3$ ,从热力学角度,氧化电 位与材料的稳定性有关,说明在 ChCl-EG 体系中 共沉积得到的 Ni-Co 合金比单质 Co、单质 Ni 具 有更高的稳定性。

# 2.3 Ni-Co 合金在 ChCl-EG 中的结晶动力学

计时电流法常被用于表征金属离子的电结 晶过程,由 Oscar 等<sup>[18]</sup>提出的适用于二元合金的 成核模型:

$$i = -\frac{D_w FC}{\sqrt{\pi D_a t}}$$

$$\left(1 - \exp\left[-N_0 \pi k D_a^{\nu^2} D w^{\nu^2} \left(t - \frac{1 - \exp(-At)}{A}\right)\right]\right)$$
(1)

$$k = \left[ 8\pi c^* \left( x_1 \frac{M_1}{\rho_1} + x_2 \frac{M_2}{\rho_2} \right) \right]$$
(2)

$$D_{w} = \frac{z_{1}D_{1}\gamma + z_{2}D_{2}}{\gamma(z_{1}x_{1} + z_{2}x_{2})}$$
(3)

$$\gamma = \frac{c_1}{c_2} \tag{4}$$

其中  $M_1$  和  $M_2$  是两种金属的摩尔质量,  $\rho_1$ 和  $\rho_2$  是两种金属的密度, F 为阿伏伽德罗常数,  $D_1$  和  $D_2$  分别为金属离子在 ChCl-EG 溶液中的 扩散系数,  $c_1$  和  $c_2$  是两种金属离子的体积浓度,  $c^*$  是假性二元合金离子体积浓度( $c^* = \gamma c_2 = c_1$ )。

结合 Oscar 等的理论研究,利用二元合金成 核理论模型对 Ni-Co 合金在 ChCl-EG 体系中电 结晶过程做进一步分析(图 6)。



图 6 ChCl-EG 体系中不同电位下的恒电位阶跃曲线 Fig. 6 Chronoamperometric current transient under different potentials in ChCl-EG system

图 6 为在-0.8~-1.1 V 电位下于 ChCl-EG 体系中测得的 Ni-Co 合金成核计时电流曲线, 阶跃次数一次,电流先上升到最大值后缓慢下 降接近平稳。电位阶跃初始,双电层充电产生 非法拉第电流。成核初期,电流上升到最大值 是由于非理想电极表面出现生长活性点,Ni-Co 合金晶核以活性点为生长中心生长,生长过程 中受晶核表面的扩散层径向作用,晶核逐渐长 大,且成核初期各个晶核扩散层之间没有交叠 影响,电流逐渐上升。电流缓慢下降接近平稳, 是由于晶体生长的活性中心发生消失与再生, 以及晶粒生长过程中扩散层出现交叠影响,扩 散层作用由径向作用转变为平面作用,导致生 长后期活性面积降低,电流开始降低并趋于 平稳。 异质基体表面成核通常为三维成核<sup>[19]</sup>,为研究 Ni-Co 合金具体的成核过程,将 *i-t* 曲线进行无因次化,与模型对比。

瞬时成核:

$$(i/i_m)^2 = [1.9542/(t/t_m)] \{1 - \exp[-1.26(t/t_m)]\}^2$$
(5)

连续成核:

$$(i/i_m)^2 = [1.2254/(t/t_m)] \{1 - \exp[-2.3(t/t_m)^2]\}^2$$
(6)

其中,*i*<sub>m</sub>和*t*<sub>m</sub>为图6中的峰电位。

图 7 为无量纲处理后的 t/t<sub>m</sub>-i/i<sub>m</sub> 曲线,与模型数据比较,试验数据接近瞬时成核模型,合金相结构的形成取决于成核速率和核生长之间的竞争,瞬时形核倾向于产生一个固溶体的合金相<sup>[20]</sup>,Ni-Co 合金多为固溶体形式存在。因此,在 ChCl-EG 中的 Ni-Co 合金的形核过程为三维瞬时成核。





为了进一步判断电结晶机理,根据 Scharifker 等<sup>[21]</sup>提出的金属离子成核理论中提到电流 *i* 与 时间 *t* 之间的关系,检验暂态初期的 *i*-tn 线性关 系,瞬时成核 n = 1/2。如图 8(a)取暂态电流上 升阶段作 *i*- $t^{1/2}$ 曲线,*i* 与  $t^{1/2}$  呈线性关系,更加验 证 Ni-Co 合金的成核过程为瞬时成核,图 8(b)取 暂态电流下降阶段作 *i*- $t^{-1/2}$ 曲线,*i*- $t^{-1/2}$ 曲线呈线 性关系,不仅证明整个电结晶过程受扩散控制, 而且 *i*- $t^{-1/2}$ 曲线斜率可以证明随沉积电位负移, 电极表面活性位点变多,结晶速率变快。因此, Ni-Co 合金在 ChCl-EG 体系中的电结晶过程属于 扩散控制下的三维瞬时成核。



Fig. 8 Plot of current *i* and  $t^{1/2}$ ,  $t^{-1/2}$ 

### 2.4 Ni-Co 合金微观形貌及元素组成

图 9 是在 ChCL-EG 低共熔型离子液体中 在-0.8~-1.1 V 的沉积电位下恒电位沉积 30 min 得到的 Ni-Co 合金 SEM 形貌,晶粒多为 尺寸较小的球状颗粒,致密且均匀排列于基体 表面,随电位负移,晶粒尺寸逐渐减小,这是由 于电沉积速率以及生长活性点数目增加引起 的,与电结晶机理分析一致。图 10 为 Ni-Co 合金表面的 EDS 能谱。随沉积电位负移,镀 层中 Co 含量从 2.94%上升到 11.56%,达到 -1.1 V 时 Co 含量下降到 4.79%,这是因为在 -1.1 V 沉积电位下的还原过程中存在 Ni<sup>2+</sup>的 还原增强发生,导致 Ni 在 Ni-Co 合金中的含量 升高,Co 含量降低。



图 9 ChCl-EG 体系中在不同沉积电位下得到的 Ni-Co 合金 SEM 形貌 Fig. 9 SEM images of Ni-Co alloy under different deposition potentials in ChCl-EG



Fig. 10 EDS analysis of Ni-Co alloy under different deposition potentials in ChCl-EG

#### 2.5 Ni-Co 合金晶型分析

图 11 为在 ChCl-EG 低共熔型离子液体中于 -0.8~-1.1 V 沉积电位下恒电位还原 30 min 的 Ni-Co 合金的 XRD 图谱,分别在 45.50°、51.80° 和 76.40°位置出现特征峰。图谱峰型与单质 Ni 谱图非常相似,这是由于 Co 的引入使其形成固 溶体 Ni-Co 合金, Co 固溶于 Ni 的晶格中,使得晶 体依然为立方结构,与单质 Ni 相似<sup>[22]</sup>,并形成较 宽的特征峰。随沉积电位负移,特征峰逐渐变 宽,Ni-Co 合金的晶粒得到细化。



图 11 在 ChCl-EG 体系中不同沉积电位下 Ni-Co 合金的 XRD 图谱

Fig. 11 XRD patterns of Ni-Co alloys Under different deposition potentials in ChCl-EG system

## 3 结 论

(1) ChCl-EG 体系主要以胆碱结构和氢键结构形式存在,随着金属盐的加入, ChCl-EG 原有的有机结构不会被破坏。

(2)低共熔型离子液体 ChCl-EG 体系的电 化学窗口为-1.2~1.0 V,Ni-Co 合金在该体系下 还原电位为-0.6~-1.13 V,通过恒电位法得到 的 Ni-Co 合金晶粒呈球形且尺寸较小,致密排列 于基体表面,该电结晶过程为受扩散控制下的三 维瞬时成核生长。随电位负移,Ni-Co 合金晶粒 的尺寸减小,且 Ni-Co 合金中的 Co 含量也从 2.94%上升到 11.56%,达到-1.1 V 时 Co 含量下 降为 4.79%。

# 参考文献

[1] 唐喆.离子液体辅助合成介孔氧化铝[D].青岛:中国石油大学(华东),2013.

TANG Z. Ionic liquid assisted synthesis of mesoporous alumina[D]. Qingdao: China University of Petroleum (East China), 2013(in Chinese).

- [2] SUN Y, HUANG H, VARDHAN H, et al. Facile approach to graft ionic liquid into MOF for improving the efficiency of CO<sub>2</sub> chemical fixation [J]. Acs Applied Materials and Interfaces, 2018, 10(32): 27124-27130.
- [3] 王治明. 离子液体的合成及其在有机合成中的应用[D]. 杭州:浙江大学, 2007.

WANG M Z. Synthesis of ionic liquid and its application in organic synthesis[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2007 (in Chinese).

- [4] LEGEAI S, SEBASTIEN D, STEIN N, et al. Room-temperature ionic liquid for lanthanum electrodeposition [J]. Electrochemistry Communications, 2008, 10(11): 1661–1664.
- [5] LI M, WANG Z, REDDY R G. Cobalt electrodeposition using urea and choline chloride [J]. Electrochimica Acta, 2014, 123: 325-331.
- [6] 谭勇,张久凌,孙杰. ChCl-EG 低共熔溶剂体系中镍沉积的 电化学行为研究[J].表面技术,2018,47(11):255-260. TAN Y, ZHANG J L, SUN J. Study on electrochemical behavior of nickel deposition in ChCl-EG eutectic solvent system
  [J]. Surface Technology, 2018, 47(11):255-260 (in Chinese).
- YANG P, ZHAO Y, SU C, et al. Electrodeposition of Cu-Li alloy from room temperature ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [J]. Electrochimica Acta, 2013, 88(2): 203-207.
- [8] WANG S, GUO X, YANG H, et al. Electrodeposition mechanism and characterization of Ni-Cu alloy coatings from a eutectic-based ionic liquid [J]. Applied Surface Science, 2014, 288: 530-536.
- [9] 张世艳,张伦武,魏小琴,等.模拟海洋环境中Ni-Co合金镀层对AZ91D 镁合金的腐蚀防护研究[J].表面技术,2017(9):229-234.
  ZHANG SY, ZHANG LW, WEI X Q, et al. Corrosion protection of Ni-Co alloy coating on AZ91D magnesium alloy in simulated marine environment[J]. Surface Technology, 2017 (9):229-234(in Chinese).
- [10] MATTEI G, CDE J F, MAZZOLDI P, et al. Synthesis, structure, and magnetic properties of Co, Ni, and Co-Ni alloy nanocluster-doped SiO<sub>2</sub> films by sol-gel processing [J]. Chemistry of Materials, 2002, 14(8): 3440-3447.
- [11] YAMAUCHI T, TSUKAHARA Y, YAMADA K, et al. Nucleation and growth of magnetic Ni-Co (core-shell) nanoparticles in a one-pot reaction under microwave irradiation[J]. Chemistry of Materials, 2010, 23(1): 75-84.
- [12] YOU Y H, GU C D, WANG X L, et al. Electrodeposition of Ni-Co alloys from a deep eutectic solvent [J]. Surface & Coatings Technology, 2012, 206: 3632-3638.
- [13] SRIVASTAVA M, YOGANANDAN G, GRIPS V K W. Electrodeposition of Ni and Co coatings from ionic liquid[J].

Surface Engineering, 2012, 28(6): 424-429.

- [14] WHITEHEAD A H, POLZLER M, GOLLAS B. Zinc electrodeposition from a deep eutectic system containing cholinechloride and ethylene glycol[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2010, 157(6); 328-334.
- [15] FLETCHER S. Some new formulae applicable to electrochemical nucleation/growth/collision [J]. Electrochimica Acta, 1983, 28(7): 917-923.
- [16] ABBOTT A P, EL TTAIB K, RUDER K S. Electrodeposition of nickel using eutectic based ionic liquids[J]. Transactions of the IMF, 2008, 86: 234-240.
- [17] HU M J, LIN B, YU S H. Magnetic field-induced solvothermal synthesis of one-dimensional assemblies of Ni-Co alloy microstructures[J]. Nano Research, 2008, 1(4): 303-313.
- [18] OSCAR D M, MOSTANY J, CARLOS B, et al. Current transient study of the kinetics of nucleation and diffusion-con-

trolled growth of bimetallic phases[J]. Journal of Solid State Electrochemistry, 2013, 17(2): 345-351.

- TSUDA T, NOHOHIRA T, ITO Y. Nucleation and surface morphology of aluminum-lanthanum alloy electrodepsited in a LaCl-saturated AlCl-EtMeImCl room temperature molten salt
   [J]. Electrochimica Acta, 2003, 47(17); 2817-2822.
- [20] LIN Y P, ROBERT S J. Electrodeposition of Ni-Zn alloy II: electrocrystallization of Zn, Ni, and Ni-Zn alloy [J]. Electrochimica Acta, 1993, 140(5): 1304-1311.
- [21] SCHARIFER B, HILLS G. Theoretical and experimental studies of multiple nucleation [J]. Electrochimica Acta, 1983, 28(7): 879–889.
- [22] SYUKRI, BAN T, OHYA Y, et al. A simple synthesis of metallic Ni and Ni-Co alloy fine powders from a mixed-metal acetate precursor [J]. Materials Chemistry and Physics, 2003, 78(3): 645-649.